



平成29年7月31日

各 位

会社名 アピックヤマダ株式会社
代表者名 代表取締役社長 押森 広仁
(コード番号 6300 東証二部)
問合せ先 取締役企画部長 小出 篤
(TEL. 026-275-2111)

(訂正) 「平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成24年2月7日に開示いたしました「平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 訂正内容及び理由

訂正内容及び理由につきましては、本日公表の「過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後の全文を添付し、訂正の箇所には下線を付して表示しております。

以上

(訂正後)



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年2月7日
上場取引所 東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社
コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 野中 正樹
問合せ先責任者 (役職名) 企画部長 (氏名) 小出 篤 TEL 026-275-2111
四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日
配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無: 無
四半期決算説明会開催の有無: 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日~平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	7,778	△30.2	△901	-	△856	-	△1,592	-
23年3月期第3四半期	11,144	81.1	741	-	845	-	816	-

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 △1,697百万円(-%) 23年3月期第3四半期 727百万円(-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	△128.18	-
23年3月期第3四半期	65.67	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第3四半期	11,235	4,470	39.8
23年3月期	12,799	6,167	48.2

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 4,470百万円 23年3月期 6,167百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	-	0.00	-	0.00	0.00
24年3月期	-	0.00	-		
24年3月期(予想)				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 無

配当予想の修正については、平成24年2月2日に公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	10,300	△23.1	△1,140	-	△1,110	-	△1,850	-	△148.86

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

連結業績予想の修正については、平成24年2月2日に公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
 新規 一社 （社名） 、除外 一社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	24年3月期3Q	12,969,000株	23年3月期	12,969,000株
② 期末自己株式数	24年3月期3Q	541,296株	23年3月期	540,647株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	24年3月期3Q	12,427,979株	23年3月期3Q	12,429,037株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) 四半期連結損益計算書関係	8
(5) セグメント情報等	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
(7) 重要な後発事象	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興に向けて穏やかな回復傾向にあります。米国経済の回復鈍化や欧州における債務問題の拡大懸念等、不安定な金融情勢を背景に円高の長期化、株価の低迷、さらにタイの洪水の影響など懸念すべき問題が多く、企業を取り巻く環境は厳しい状況で推移しました。

このような状況のもとで、当社グループは、全社を挙げて一層のコスト削減に努めるとともに、市場に対する取組みとしては、LED、一般半導体分野に対しては更なる生産性の向上を目指した大判対応トランスファーモールド装置を発売し、ハイエンド半導体分野に対しては、ウェハレベルパッケージ装置のコスト低減と拡販、車載半導体分野に対しては新規パッケージ開発の強化に取組みました。また半導体以外の分野への取組みとしてはRFIDタグの開発などを推進してまいりました。しかしながら、パソコンやデジタル家電の伸び悩みの影響により、半導体メーカーの設備投資は低調に推移し、引続き当社グループの受注環境は厳しい状況となりました。

なお、当第3四半期連結累計期間において、連結子会社であるアピックヤマダ タイランド カンパニー リミテッド（以下同社という）は、タイ国における大規模な洪水災害により、工場設備、機械が甚大な被害を受けました。工場の復旧には多額の費用と時間がかかることが想定され、また同社の同工業団地内の主力取引先が閉鎖を決めたことにより、事業継続は困難との結論に至り、平成23年12月26日に同社の事業を閉鎖いたしました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は7,778百万円（前年同四半期比30.2%減）、営業損失は901百万円（前年同四半期は営業利益741百万円）、経常損失は856百万円（前年同四半期は経常利益845百万円）、四半期純損失は1,592百万円（前年同四半期は四半期純利益816百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置につきましては、半導体およびLEDの在庫調整が継続しており、国内外ともに設備投資が抑制され、受注環境は厳しい状況にて推移いたしました。

この結果、売上高は4,083百万円（前年同四半期比40.0%減）、セグメント損失は187百万円（前年同四半期はセグメント利益1,107百万円）となりました。

②電子部品

電子部品につきましても、主にリードフレームという半導体、LEDの生産に使用される部品であります。半導体およびLEDの生産調整により生産数量が低迷し、その影響を受けて受注数量は低調な動きとなりました。

この結果、売上高は3,082百万円（前年同四半期比8.3%減）、セグメント損失は291百万円（前年同四半期はセグメント損失13百万円）となりました。

③その他

その他につきましては、リード加工金型およびリードフレーム生産用金型の販売を行っておりますが、上記同様設備投資の抑制により、受注・売上ともに厳しい状況となりました。

この結果、売上高は612百万円（前年同四半期比37.3%減）、セグメント利益は50百万円（前年同四半期比51.6%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、11,235百万円（前連結会計年度末は12,799百万円）となり、前連結会計年度末と比較して1,563百万円減少いたしました。これは主に現金および預金の減少、売掛金の減少、および連結子会社のアピックヤマダ タイランド カンパニー リミテッドの水害と事業閉鎖に伴う原材料の減少、機械および装置等固定資産の減少によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は6,765百万円（前連結会計年度末は6,631百万円）となり、前連結会計年度末と比較して133百万円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。

当第3四半期連結会計年度末における純資産合計は、4,470百万円（前連結会計年度末は6,167百万円）となり、前連結会計年度末と比較して1,697百万円減少いたしました。これは主に四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は39.8%（前連結会計年度末は48.2%）となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

半導体市況の悪化により、半導体業界において生産調整および生産調整による設備投資抑制の動きが継続しており、当社の電子部品製造装置、電子部品とも受注の低迷が続いております。また、平成23年12月26日に公表いたしましたとおり当社の連結子会社であるアピックヤマダ タイランド カンパニー リミテッドがタイ国の洪水で被災し、平成23年12月26日に事業閉鎖となりました。これらの状況を考慮し、平成24年2月2日に「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、通期見通しとして大幅な減収・減益が見込まれますので、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益について下方修正いたしました。また、配当予想につきましても、上記通期連結業績予想を踏まえ、大変遺憾ながら無配とさせていただくことといたしました。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,031,247	2,442,266
受取手形及び売掛金	2,928,550	2,225,883
商品及び製品	536,506	640,637
仕掛品	894,958	1,404,153
原材料及び貯蔵品	441,754	301,014
その他	236,601	158,692
貸倒引当金	△1,047	—
流動資産合計	8,068,572	7,172,649
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,508,920	1,231,680
機械装置及び運搬具(純額)	835,262	656,161
土地	854,195	845,999
その他(純額)	284,948	169,662
有形固定資産合計	3,483,326	2,903,504
無形固定資産	203,525	149,068
投資その他の資産		
関係会社出資金	502,387	537,322
その他	551,650	480,979
貸倒引当金	△10,299	△8,098
投資その他の資産合計	1,043,738	1,010,202
固定資産合計	4,730,590	4,062,775
資産合計	12,799,162	11,235,425
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,084,973	2,147,027
短期借入金	2,240,000	2,673,800
1年内返済予定の長期借入金	208,800	210,500
未払法人税等	32,324	6,707
賞与引当金	124,150	56,000
製品保証引当金	44,505	29,947
その他	571,589	456,876
流動負債合計	5,306,344	5,580,857
固定負債		
長期借入金	384,200	227,600
退職給付引当金	831,184	796,577
その他	109,520	160,190
固定負債合計	1,324,904	1,184,367
負債合計	6,631,249	6,765,225

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	1,181,031	<u>△411,964</u>
自己株式	△99,641	△99,766
株主資本合計	<u>6,918,889</u>	<u>5,325,768</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△4,930	△13,986
為替換算調整勘定	△746,045	△841,582
その他の包括利益累計額合計	<u>△750,975</u>	<u>△855,568</u>
純資産合計	<u>6,167,913</u>	<u>4,470,199</u>
負債純資産合計	<u>12,799,162</u>	<u>11,235,425</u>

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	11,144,325	7,778,880
売上原価	8,541,236	6,837,518
売上総利益	2,603,089	941,361
販売費及び一般管理費	1,861,144	1,843,153
営業利益又は営業損失(△)	741,945	△901,791
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,568	2,988
持分法による投資利益	78,270	34,320
受取技術料	25,460	31,445
その他	63,113	58,056
営業外収益合計	169,413	126,811
営業外費用		
支払利息	48,436	46,942
為替差損	4,994	26,803
売上債権売却損	10,098	4,108
その他	2,128	4,152
営業外費用合計	65,658	82,007
経常利益又は経常損失(△)	845,700	△856,986
特別利益		
固定資産売却益	16,632	44,447
特別利益合計	16,632	44,447
特別損失		
固定資産除却損	2,226	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	21,268	—
その他	185	—
災害による損失	—	※1 573,116
工場閉鎖損失	—	※2 144,145
特別損失合計	23,680	717,262
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	838,651	△1,529,801
法人税、住民税及び事業税	22,332	19,782
法人税等調整額	54	43,412
法人税等合計	22,386	63,194
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	816,265	△1,592,996
四半期純利益又は四半期純損失(△)	816,265	△1,592,996

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	816,265	<u>△1,592,996</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△11,282	△9,056
為替換算調整勘定	△37,366	△81,474
持分法適用会社に対する持分相当額	△39,718	△14,063
その他の包括利益合計	<u>△88,367</u>	<u>△104,593</u>
四半期包括利益	<u>727,898</u>	<u>△1,697,589</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	727,898	<u>△1,697,589</u>
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4) 四半期連結損益計算書関係

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
※1 災害による損失	—	平成23年10月に発生したタイ国洪水に伴うたな卸資産の滅失損失、固定資産の滅失損失及び災害による操業休止期間中の固定費等であります。 このうち、たな卸資産及び固定資産は損害保険を付保していますが、当第3四半期連結累計期間において保険金の受取額が確定していないため、保険金収入を計上しておりません。
※2 工場閉鎖損失	—	平成23年12月26日に当社の連結子会社であるアピックヤマダ タイランドカンパニー リミテッドの工場を閉鎖したことに伴い発生した割増退職金等であります。

(5) セグメント情報等

I 前第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	電子部品 組立装置	電子部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	6,807,899	3,360,381	10,168,280	976,045	11,144,325
セグメント間の内部売上高又は振替高	42,157	—	42,157	243,703	285,860
計	6,850,056	3,360,381	10,210,437	1,219,748	11,430,186
セグメント利益又は損失(△)	1,107,183	△13,385	1,093,797	105,249	1,199,047

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフレーム金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	1,093,797
「その他」の区分の利益	105,249
セグメント間取引消去	361
全社費用(注)	△457,463
四半期連結損益計算書の営業利益	741,945

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	電子部品 組立装置	電子部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	<u>4,083,775</u>	3,082,655	<u>7,166,431</u>	612,448	<u>7,778,880</u>
セグメント間の内部売上高又は振替高	47,144	—	47,144	144,750	191,895
計	<u>4,130,920</u>	3,082,655	<u>7,213,576</u>	757,199	<u>7,970,775</u>
セグメント利益又は損失(△)	<u>△187,727</u>	△291,285	<u>△479,012</u>	50,925	<u>△428,087</u>

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフレーム金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	<u>△479,012</u>
「その他」の区分の利益	50,925
セグメント間取引消去	351
全社費用(注)	△474,054
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	<u>△901,791</u>

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

(7) 重要な後発事象
該当事項はありません。